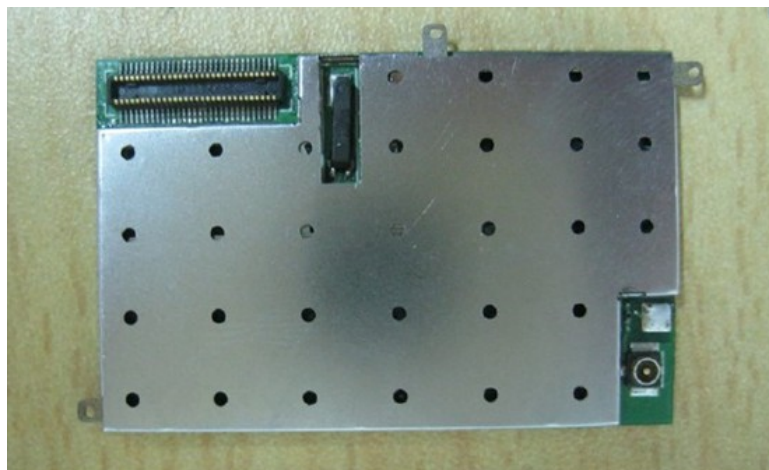
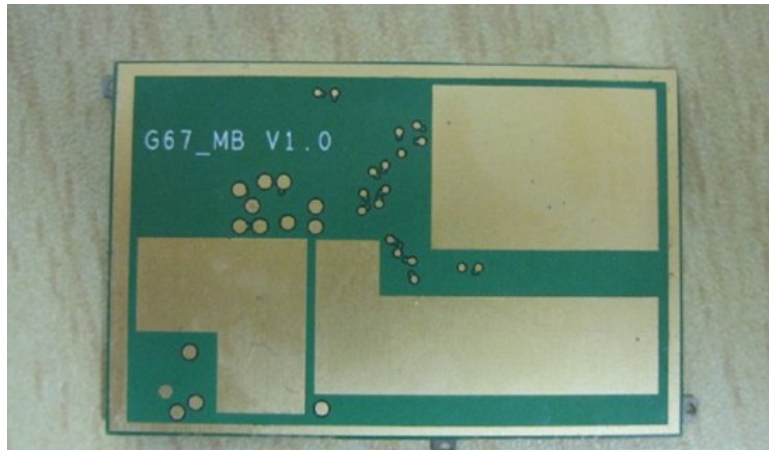


revision

版本更新记录		
版本号	更新说明	日期
V1.0	新建	20121226-

3G 模块介绍:					
推荐型号	3G Band	2G Band	语音	SIZE	制式
G3	2100M, 850M	900M/1800M/850M/1900M	√	见附图二	GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA/HSPA+
GSM/EDGE:900M/1800M/850M/1900M WCDMA: 2100M, 850M					

模块实物图:



注: 实物图片 (模块上 G67 后改为 G3)



G3 产品规格

项目		描述
产品名称	HSPA+智能机, 平板电脑带语音通话的 3G 模块	支持 GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA/HSPA+ 制式移动网络接入服务。专门针对手持终端应用设计的超薄 3G 模块, 并支持手持终端所需的多种应用, 使客户的手持 3G 终端既可快速成熟应用, 也可实现超薄设计, 满足办公及商务用户的数据业务需求。
技术规范	HSPA+ R7	下行 21M, 上行 11M
	WCDMA	下行速率 384kbps 上行速率 384kbps
	EDGE	EGPRS Class12 下行速率 237kbps 上行速率 118Kbps
	GPRS	GPRS Class12 下行速率 85.6kbps 上行速率 42.8kbps
频段	GSM/GPRS/EDGE	4+2:GSM/EDGE:900M/1800M/850M/1900M
	UMTS	4+2: 2100M, 850M
功率等级	WCDMA	Power Class 3 (24dBm +1/-3dB)
	GPRS/GSM 850/900	Power Class 4 (33dBm ±2dB)
	GPRS/GSM 1800/1900	Power Class 1 (30dBm ±2dB)
	EDGE 850/900	Power Class E2 (27dBm ±2dB)
	EDGE 1800/1900	Power Class E2 (26dBm ±2dB)
灵敏度	850M/EGSM/DCS/PCS	< -106dBm
	UMTS 2100M	< -106dBm
电源特性	工作电压	3.3 – 4.2V DC
	电压波动	3.2 – 4.5V DC
	工作电流	TBD
	休眠驻网	5mA
	语音通话最大功率	< 24dB(3G)
环境特征	工作温度	-20℃ ~ +70℃
	极限工作温度	-30℃ ~ +75℃
	存储温度	-40℃ ~ +90℃
	相对湿度	5% ~ 95%
结构特征	外形尺寸	见附图二
	重量 (克)	TBD
连接方式	主接口	60pins B2B
	辅助接口	-
	UMTS/GSM 天线接口	GSC 天线馈点



60pin 连接 器 主要 硬件 功能 接口	SIM/USIM 接口	支持, 兼容 3GPP 31.101 和 31.102 规范
	USB	高速 USB 2.0
	UART	通用 4 线串口
	I2C	标准 I2C
	PCM	支持 PCM
	GPIO	通用 IO 口
	SDIO	micro SD/TF
	WIFI	WIFI 接口, 可用于扩展外接 WIFI 模块
	指示灯	2 个 LED 状态指示
主要 软件 功能	AT Command	支持 3GPP TS 27.005 和 3GPP TS27.007 规范
	data	支持
	voice	支持
	SMS	支持
	phone book	支持
	TCP/IP	支持
	MMS push messg.	支持
	UTK	支持
	OTA	支持
	PIN1	支持, 支持启用/关闭/修改 PIN 码
	网络参数	暂不支持
	OS 支 持	Windows
MAC OS		支持
LINUX		支持
ANDROID		支持
认证 (需 要去 过吗)	ROHS 认证	符合 ROHS 标准
	CE 认证	符合 CE 标准
	其他	可以视具体需求确定

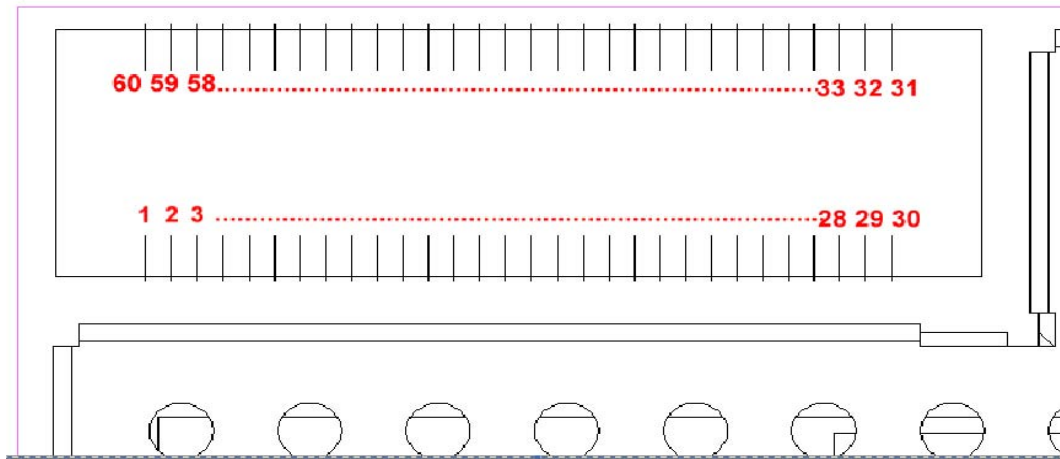


G3 模块接口定义:

主连接器			60pins B2B		
连接器型号			AXK860145WG		
连接器闭合高度			1.5mm		
连接器厂家			Panasonic		
Pin #	内部定义	GPIO 功能使用建议	Pin #	内部定义	GPIO 功能使用建议
1	VBAT		60	VBAT	
2	VBAT		59	VBAT	
3	GND		58	GND	
4	UART0_CTS_N		57	VBUS_I N	NC 或上拉到 VBAT
5	UART0_RTS_N		56	PCM_D OUT	
6	UART0_RX_DATA		55	PCM_D IN	
7	UART0_TX_DATA		54	PCM_C LK	
8	SPI_CLK		53	PCM_S YNC	
9	SPI_CSNO		52	SPI_M OSI_D ATA	
10	GND		51	GPIO_1 06	BB_WAKEUP_AP
11	USIM_DATA		50	GND	
12	USIM_RESET		49	USB_D M	
13	USIM_CLK		48	USB_D P	
14	VSIM		47	GND	
15	VDD_IO	2.8V	46	VDD_S DIO	SDIO
16	GPIO_41/HEADMIC_IN	HS_DET	45	SD0_D ATA3	
17	AUXMICN		44	SD0_D ATA2	
18	AUXMICP		43	SD0_D ATA1	
19	HPH_L_P		42	SD0_D	

				ATA0	
20	HPH_RN		41	SD0_C MD	
21	HSED_BIAS		40	SD0_C LK	
22	MICN		39	GPIO_1 05	AP_WAKEUP_BB
23	MICP		38	GPIO_2 0	用户自己配置
24	EARP		37	GND	
25	EARN		36	EXT_R STN	低电平有效，内部上拉到VBAT
26	GND		35	GPIO_2 1	用户自己配置
27	SPI_MISO_DATA		34	GPIO_1 9	SDIO_PWR_EN
28	I2C_SCL		33	KPLED	KEYPAD BACKLIGHT DRIVER
29	I2C_SDA		32	POWE RKEY	低电平有效，内部上拉到VBAT
30	GND		31	GND	

附图一：
连接器管脚排序图





中升科技有限公司

附图二：
模块尺寸图

